

即時發表

經辦代理:

David Moreno (大衛穆銳農)

Open Sky Communications

電話: +1-415-519-3915

電郵: dmoreno@openskypr.com

EBeam Initiative 行業專家調查預測：今年光罩市場將持續增長

eBeam Initiative 歡迎 AGC 成為其最新成員

加州聖荷西，2025 年 9 月 23 日——致力於教育和推廣基於電子束（eBeam）技術的新型半導體製造方法的論壇組織「電子束倡議」（eBeam Initiative）今日宣佈，其第十四屆年度「電子束倡議業界精英」（eBeam Initiative Luminaries）調查已完成。來自半導體生態系統中 51 家公司的行業專家——涵蓋光罩、電子設計自動化（EDA）、晶片設計、設備、材料、製造和研究領域——參與了今年的調查。電子束倡議組織同時宣佈，AGC 已作為其最新成員加入。

調查主要結論

參與調查的專家中有 64% 預測，2025 年的光罩收入將較 2024 年有所增長，這一觀點與 SEMI（國際半導體產業協會）預測的 2025 年同比增長 5% 相符(1)。在一個新的調查問題中，光罩刻寫機（mask writing）被列為 2026 年先進製程投資的首要任務，緊隨其後的是光罩檢測與修復（mask inspection and repair）以及光學鄰近效應校正（OPC）/ 逆向微影技術（ILT）。在一個相關的問題中，88% 的受訪專家預測，未來三年內多電子束光罩刻寫機（multi-beam mask writer）的採購量將會增加。

EUV 微影和曲線光罩（curvilinear masks）是影響光罩市場的兩個重要技術趨勢。高數值孔徑 EUV 微影（High-NA EUV lithography）針對最先進的製程節點，目前正在開發中。在一個關於高數值孔徑 EUV 對光罩製造商影響的問題中，40% 的專家現在認為所需的光罩次解析度輔助圖形（SRAFs）的最小尺寸為 15 奈米或以下，高於去年的 29%。關於曲線光罩，業界對其製造能力的信心持續高漲，77% 的受訪者表示，到明年年底，領先的光罩廠能夠在大量生產（HVM）中處理至少數量有限的曲線光罩。

此次行業專家調查的完整結果將於今晚在加州蒙特雷舉行的 SPIE 光罩技術+EUV 微影會議期間的一場特別電子束倡議組織活動上，由一個專家小組進行介紹和討論。活動結束後，調查結果可在 www.ebeam.org 網站下載。AGC 也將在此次活動上被確認為電子束倡議組織的最新成員，該組織現已擁有超過 50 家成員公司。

「我們非常高興歡迎 AGC 加入電子束倡議組織，」電子束倡議組織的主辦管理公司 D2S 的執行長藤村先生(Aki Fujimura)表示，「光罩市場的持續增長凸顯了光罩供應鏈的每一個環節對於半導體製造其他部分的重要性。作為光罩基板領域的領先供應商，AGC 帶來了獨特的視角，這將有助於加強我們提升行業認知和促進跨行業合作的共同努力。」

Reference

(1) Source: [Photomask Market Characterization Study](#), SEMI, August 8, 2025

關於 eBeam Initiative (電子束倡議團)

eBeam Initiative 是一個致力於推廣和宣導電子束技術在半導體製造全新應用的團體；為有關電子束技術的教育和促進活動提供相應的論壇。eBeam Initiative 的目標是增加電子束技術應用在半導體製造各領域中的投資；降低電子束技術應用的障礙，能夠使更多積體電路設計完成，並且更快投進市場成為可能。會員公司，涵蓋整個半導體生態系統，包括: aBeam Technologies; Advantest; AGC; Alchip Technologies; AMD; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; ASML; Averroes.ai; Cadence Design Systems; Canon; CEA-Leti; D2S; Dai Nippon Printing; EQUIcon Software GmbH Jena; ESOL; EUV Tech; Fractilia; Fraunhofer IPMS; FUJIFILM Corporation; Fujitsu Semiconductor Limited; GenISys GmbH; GlobalFoundries (GF); Grenon Consulting; Hitachi High-Tech Corporation; HJL Lithography; HOLON CO., LTD; HOYA Corporation; IBM; imec; IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; JEOL; KIOXIA; KLA; Micron Technology; Multibeam Corporation; NCS; NuFlare Technology; Petersen Advanced Lithography; Photronics; QY Mask; Samsung Electronics; Semiconductor Manufacturing International (Shanghai) Corporation (SMIC); Siemens EDA; STMicroelectronics; Synopsys; TASMIC; Tokyo Electron Ltd. (TEL); TOOL Corporation; Tekscend Photomask; UBC Microelectronics; Vistec Electron Beam GmbH and ZEISS. eBeam Initiative 面向和歡迎所有電子工業的公司和協會加盟。細節請查看 www.ebeam.org.

###